Title: DSP硬件设计——外扩RAM

Time: 2016-1-23 17:54:14

1. TTL电平、COMS电平

目前区别看来是高低电平的电平标准:

**TTL电平**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 引脚电器方向 | 逻辑高电平（1） | 逻辑低电平（0） |
| Out | >2.0V | <1.2V |
| in | >2.4V | <0.8V |

**COMS电平**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 引脚电器方向 | 逻辑高电平（1） | 逻辑低电平（0） |
| Out | >0.7xVcc | <0.3xVcc |
| in | >0.9xVcc | <0.8V |

1. 上拉、下拉和高阻态

上拉：地——下拉电阻——节点。目的是保持节点电平稳定为低。

下拉：VCC——上拉电阻——节点。保持节点为高电平。

高阻态：悬空，或者说开路。

3.BootRom 引导模式

BootRom可根据烧写的固件代码进行引导工作，也可以通过SCI,SPI,CAN,I2C等模块跳转到其他存储器中进行引导工作。